

[进入PCB/激光钢网下单系统] (/consumer/login.html) [进入立创元器件商城网站] (https://www.szlsc.com/)

[电信入口] (http://dx.sz-jlc.com) [联通入口] (http://lt.sz-jlc.com) [移动入口] (http://dx.sz-jlc.com) [添加到收藏夹] (JavaScript:collect();)

(/)

新

PCB首页 (/) 在线计价 (/portal/vorderadd.html) 工厂参观 (/portal/vfactory.html?factory) 产品展示 (/portal/vproduct.html?smt)

工艺参数 (/portal/vtechnology.html) SMT打样 (/portal/newV2/smt.jsp) 下单流程 (/portal/newV2/place.jsp)

关于我们 (/portal/vcontact.html?1)

PCB/电路板打样首选嘉立创

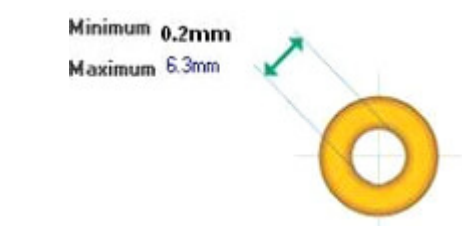
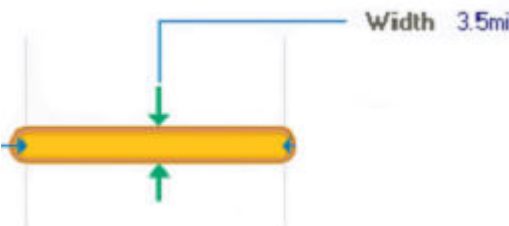
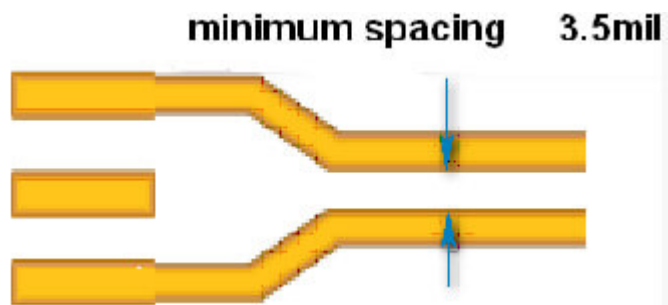
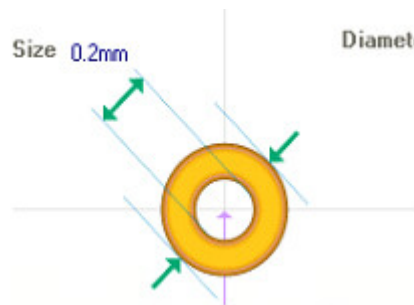

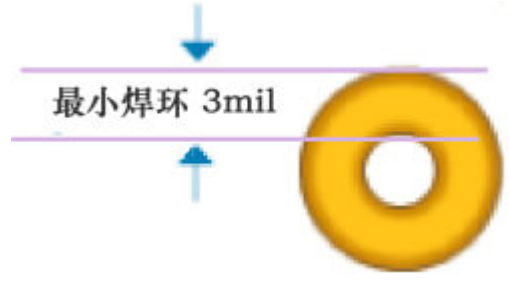
10年行业专业经验

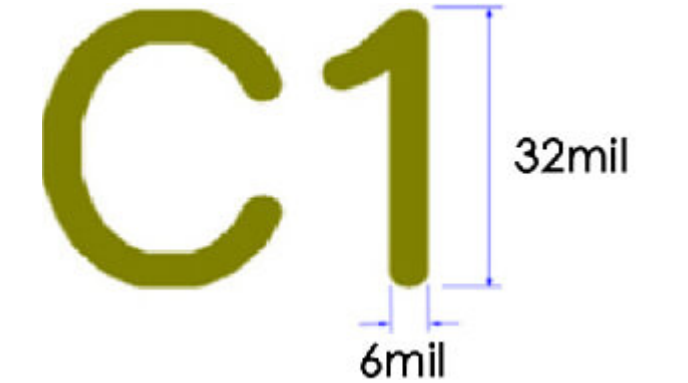
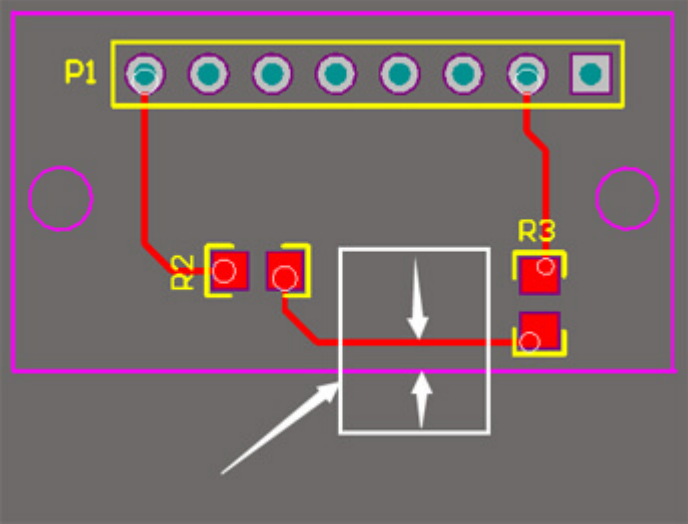
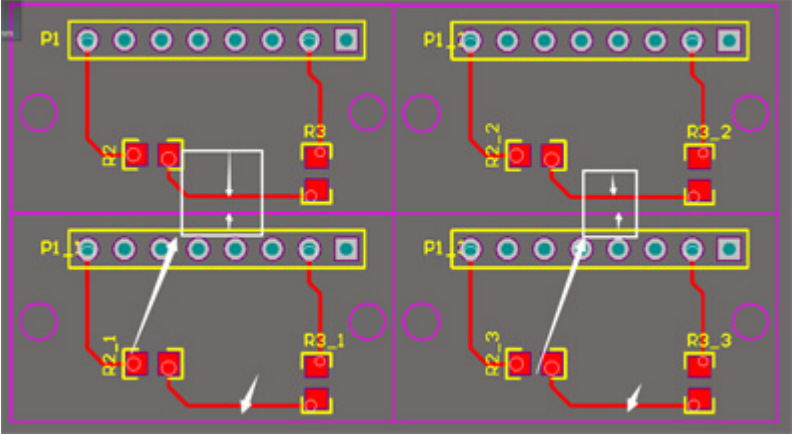
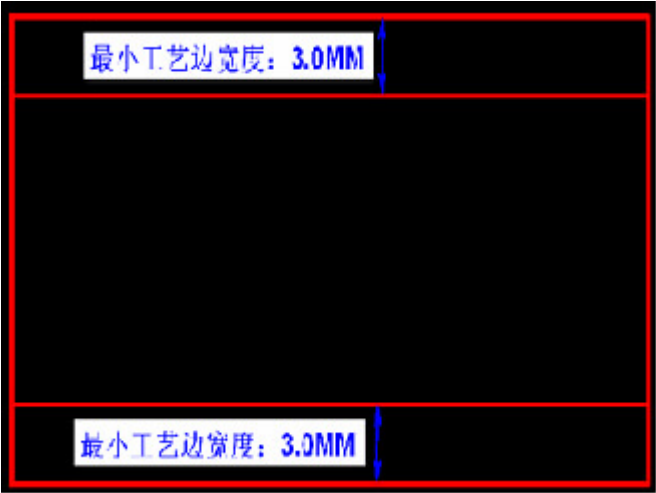
THE FIRST CHOICE OF THE PCB/ CIRCUIT BOARD IS JIA LICHUANG
TEN YEARS' PROFESSIONAL EXPERIENCE IN INDUSTRY

工艺参数

项目	加工能力	工艺详解	图解
层数	1~6层	层数，是指PCB中的电气层数（敷铜层数）。目前嘉立创只接受1~6层板	
多层板阻抗	4层，6层	嘉立创2018年多层板支持阻抗设计，阻抗板不另行收费	嘉立创阻抗多层板：层压结构及参数 (http://club.szlsc.com/article/details_11533_1.html) 嘉立创阻抗条现场测试图 (http://club.szlsc.com/article/details_11485_1.html)

项目	加工能力	工艺详解	图解
板材类型	FR-4板材	板材类型：纸板、半玻纤、全玻纤（FR-4）、铝基板，目前嘉立创只接受FR-4板材。如右图	<div>FR-4</div> <div></div> <div>Copper（铜箔）</div> <div>P片（玻璃纤维布+环氧树脂）</div> <div>Copper（铜箔）</div>
采用生产工艺	FR-4板材	传统镀锡工艺正片	灾难性的负片工艺再出江湖，用此工艺为品质灾难，详情 www.sz-jlc.com/portal/t7i1278.html (/portal/t7i1278.html)
最大尺寸	40cm * 50cm	嘉立创开料裁剪的工作板尺寸为40cm * 50cm，通常允许客户的PCB设计尺寸在38cm * 38cm以内，具体以文件审核为准。	
阻焊类型	感光油墨	感光油墨是现在用得最多的类型，热固油一般用在低档的单面纸板。如右图	<div></div> <div>绿油</div> <div>红油</div> <div>黄油</div> <div>蓝油</div> <div>白油</div> <div>黑油</div>
成品外层铜厚	1oz~2oz (35um~70um)	默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1oz，最多可做2oz（需下单备注说明）。如右图	<div>以四层板为例，</div> <div></div> <div>Top Layer：10Z/0.035mm</div> <div>Layer 2</div> <div>Layer 3</div> <div>Bottom Lauer：10Z/0.035mm</div>
成品内层铜厚	0.5oz（17um）	默认常规电路板内层铜箔线路厚度为0.5oz。如右图	<div>以四层板为例，</div> <div></div> <div>Top Layer</div> <div>Layer 2：0.5oz/0.017mm</div> <div>Layer 3：0.5oz/0.017mm</div> <div>Bottom Layer</div>
外形尺寸精度	±0.2mm	板子外形公差±0.2mm。	
板厚范围	0.4~2.0mm	嘉立创目前生产板厚：0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm。	
板厚公差 (T≥1.0mm)	± 10%	比如板厚T=1.6mm，实物板厚为1.44mm（T - 1.6×10%）~1.76mm（T + 1.6×10%）	
板厚公差 (T<1.0mm)	±0.1mm	0.7mm（T-0.1）~0.9mm（T+0.1）	

项目	加工能力	工艺详解	图解
钻孔孔径（机械钻）	0.2~6.3mm	最小孔径0.2mm，最大孔径6.3mm，如果大于6.3mm工厂要另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶，如0.2，0.3mm	
孔径公差（机器钻）	±0.08mm	钻孔的公差为±0.08mm，例如设计为0.6mm的孔，实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的。	
线宽	3.5mil	多层板3.5mil 单双面板5 mil	
线隙	3.5mil	多层板3.5mil 单双面板5 mil	
最小过孔内径 及外径	内径(hole)最小0.2mm,外径(diameter)最小0.45mm	多层板最小内径0.2mm，最小外径为0.45mm，双面板最小内径0.3mm,最小外径0.6mm	
焊盘边缘到线距离	5mil	参数为极限值，尽量大于此参数	
过孔单边焊环	3mil	参数为极限值，尽量大于此参数	

项目	加工能力	工艺详解	图解
最小字符宽	线宽6mil 字符高32mil	参数为极限值，尽量大于此参数	
单片出货：走线和焊盘距板边距离	≥0.2mm	否则可能涉及到板内的线路及焊盘	
拼版V割出货：走线和焊盘距板边距离	≥0.4mm	否则可能涉及到板内的线路及焊盘,如右图，如果是拼版，则线离边必须要有0.4mm间距，否则v割会伤到线路。如果是单片出货，则需要帮≥0.2mm的间距。	
最小工艺边	3mm		

项目	加工能力	工艺详解	图解
拼板：无间隙拼板	0mm间隙拼板	板子与板子的间隙为0mm。点击查看大图 (/portal/images/zuix_gyzs_b30-858b43877d.jpg)	
拼板：有间隙拼板	1.6mm间隙拼板	有间隙拼版的间隙不要小于2.0mm，否则锣边时比较困难。 点击查看大图 (/portal/images/zuix_gyzs_b33-04969d5275.jpg)	
半孔工艺最小孔径	0.6mm	半孔工艺是一种特殊工艺，最小孔径不得小于0.6mm。小于0.6MM 做不出半孔的效果	
阻焊层开窗	0.05mm	绿油桥小于3mil不保留，绿油桥大于3mil保留,不以阻焊桥为检验出货标准	
注意事项1： Pads厂家铺铜方式	Hatch方式铺铜	厂家是采用还原铺铜（Hatch），PADS软件设计的客户请务必注意。如右图	
注意事项2： Pads软件中画槽	用Outline线	如果板上的非金属化槽比较多，请用outline画	

关于我们 (/portal/vcontact.html) | 产品中心 (/portal/vproduct.html) | 服务与支持 (/portal/vcontact.html?1) | 下载中心 (/portal/appDownloadsWithConfig.html?init=pc&x=0.42017755101209686)

联系方式：0755 - 82048201/82048204 QQ:800005884(售后) 传真：0755-82048202
公司地址：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦27楼
集团旗下事业部： PCB事业部 (/) | 激光钢网事业部 (http://www.jlc-gw.com/)
友情链接： 立创元器件商城 (http://www.szlcsc.com/) | 立创EDA (https://lceda.cn) | 手机网页版 (/phone/index.html?s=a)



版权所有 · 深圳市嘉立创科技发展有限公司 粤ICP备11084592号-1 (http://www.miitbeian.gov.cn)

 粤公网安备44030402002110 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=44030402002110)